

附件 1

2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策 专项资金申报指南

一、支持对象

在武汉市登记注册，具有独立法人资格的集成电路企业和集成电路设计企业。

集成电路企业需同时符合下列条件：

1. 主营业务为集成电路设计、制造、封测、设备、材料的企业。

2. 企业财务会计制度健全，税务征管关系在武汉市内，并依法纳税。

3. 不违反国家、省、市联合惩戒政策和制度规定，近三年无不良信用记录，符合国家、省、市环保、安全生产、产品质量等要求。

4. 有完整的全职研发团队，具备自主研发能力。

集成电路设计企业需同时符合下列条件：

1. 符合上述 4 条规定，并以集成电路设计为主营业务。

2. 拥有自主知识产权（如集成电路布图设计登记证书、发明专利授权等），并以此为基础开展经营活动。

3. 具有与集成电路设计相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境（如电子设计自动化（EDA）工具、合法的开发工具

等），以及与所提供服务相关的技术支撑环境。

二、支持周期

支持周期即为后文所称“年度”，起止时间为：2022年7月1日—2023年6月30日（本政策属于后奖补政策，奖补依据为企业在支持周期内实际发生的费用）。

三、支持政策

企业可同时申报以下1-2项奖补政策（最终只能按就高原则享受其中一项）。其中流片补贴、设计费用补贴仅限集成电路设计企业申报。

（一）流片补贴

1.对完成全掩膜（Full Mask）首轮工程产品流片的集成电路设计企业，给予首轮流片费用30%或首轮掩膜版制作费用50%的补贴，单个企业年度补贴总额最高500万元。

2.对使用多项目晶圆（MPW）流片进行研发的集成电路设计企业，给予MPW首轮流片费用50%的补贴，单个企业年度补贴总额最高100万元。

（二）设计费用补贴

1.给予购买IP、EDA实际支出费用的30%、年度总额最高200万元的补贴。

2.给予复用、共享我市第三方集成电路设计平台的IP设计工具软件或者测试分析系统实际投入的50%、年度总额最高100万元的补贴。

（三）销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励

1.对于企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片年度销售金额累计超过 500 万元的，按照年度销售金额 10%给予一次性奖励，单款芯片年度奖励最高不超过 500 万元。单个企业在政策有效期内奖励总额最高不超过 1000 万元。

2.企业销售自主研发生产的集成电路关键核心设备或材料，且单款设备或材料年度销售金额累计超过 300 万元的，按照年度销售金额 30%给予一次性奖励，单款设备或材料年度奖励最高不超过 500 万元。单个企业在政策有效期内奖励总额最高不超过 1000 万元。

3.企业销售自主研发 EDA 软件，按照单款 EDA 软件年度销售金额 50%给予一次性奖励，单款 EDA 软件年度奖励最高不超过 500 万元。单个企业在政策有效期内奖励总额最高不超过 1000 万元。

（四）企业贷款贴息

按企业年度实际支付银行贷款利息金额的 50%给予贷款贴息，单个企业每年贴息金额最高不超过 1000 万元。

四、申报条件

（一）流片补贴

1.企业在申报年度内进行全掩膜（Full Mask）或多项目晶圆（MPW）首轮流片。

2.经过 Full Mask 流片，达到设计要求后，可以提供给集成电路系统整机厂商进行芯片性能测试及示范应用的芯片产品，产

品须获得集成电路布图设计登记证书。

3.“首轮流片”是指集成电路设计企业为某款芯片进行的第一次流片。

4.流片费用具体包括：掩膜版制作费、用于首轮流片的晶圆购置费（不高于12片晶圆）、制造端IP授权费、测试加工费等。

（二）设计费用补贴

1.企业在申报年度内直接购买IP、EDA并用于研发。

2.企业在申报年度内复用、共享第三方集成电路（IC）设计平台的IP设计工具软件或测试分析系统。

3.购买IP不包含委托技术服务。

4.“IP”是指供应方提供的已形成知识产权并完成权属登记，可直接用于二次开发的商品。“Foundry IP”指由代工厂提供的用于流片环节的IP模块。

5.“委托技术服务”是指，委托方提出技术需求，由供应方研发，之后就该项技术形成知识产权，权属由双方自行约定。

（三）销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励

1.芯片及相关产品指以下四类产品：芯片、集成电路制造或测试设备、集成电路制造材料、EDA软件。

2.企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片年度销售金额累计超过500万元（依据会计准则核算）。

3.企业销售自主研发设计、生产制造的集成电路设备或材料，且单款产品年度销售金额累计超过300万元（依据会计准则核算）。

4.企业年度销售自主研发设计的EDA软件产品。

5.企业销售的芯片须在申报前取得集成电路布图设计专有权，销售的其他产品须拥有自主知识产权。

6.是否单款芯片、设备、材料、EDA软件，以名称、型号以及其他相关技术材料判定。

7.芯片及相关产品销售奖励每年分领域支持（以当年申报通知为准），申报企业上一年度营收同比增速不小于30%，且申报奖励的销售产品在技术、性能方面须具有较强的创新性。

8.申报销售奖励的设备、材料在技术、性能方面须具有较强的创新性。

（四）企业贷款贴息

1.企业在申报年度内为扩大研发、生产而新增的银行商业贷款，不包括企业获得的政策性银行贷款。

2.企业上一年度的集成电路主营业务收入占企业收入总额的比例不低于60%。

3.新增贷款是指年度内新核准并已发放的贷款。

4.对因逾期、违约等产生的费用一律不予补贴。

五、申报材料

企业应按申报项目分别填写制作申报材料，装订成册，于申报受理时限内提交纸质版三份及电子版至所属区（开发区）经信部门。

（一）流片补贴申报材料

1.《2023年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》（附件1）

2.《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策流片补贴申报书》（附件 2）

3.市经信局要求的其他材料

（二）设计费用补贴申报材料

1.《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》（附件 1）

2.《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策设计费用补贴申报书》（附件 3）

3.市经信局要求的其他材料

（三）销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励申报材料

1.《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》（附件 1）

2.《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策销售奖励申报书》（附件 4）

3.市经信局要求的其他材料

（四）企业贷款贴息申报材料

1.《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》（附件 1）

2.《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策贷款贴息申报书》（附件 5）

3.市经信局要求的其他材料

六、申报流程

（一）发布通知

市经信局向各区（开发区）经信部门发布资金申报通知。各区（开发区）经信部门向本辖区内企业转发资金申报通知。

（二）申报受理

各区（开发区）经信部门组织本辖区内企业开展相关申报工作。申报企业在受理时间内向所属区（开发区）经信部门提交申报材料，受理时间详见资金申报通知，逾期不予受理。

- 附件：1. 《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》
2. 《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策流片补贴申报书》
3. 《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策设计费用申报书》
4. 《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策销售奖励申报书》
5. 《2023 年度武汉市集成电路产业发展若干政策贷款贴息申报书》

武汉市经济和信息化局

2023 年 9 月 19 日